第一图书网, tushu007.com

<<半导体制造技术>>

图书基本信息

书名：<<半导体制造技术>>

13位ISBN编号：9785053949322

10位ISBN编号：5053949328

出版时间：2004-01-01

出版时间：电子工业出版社

作者：韩郑生等译

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<半导体制造技术>>

内容概要

在半导体领域，技术的变化遵循着摩尔定律的快速节奏，是以月而不是以年为单位计的。
本书详细追述了半导体发展的历史并吸收了当今最新技术资料，学术界和工业界都称赞这是一本目前在市场上能得到的最全面、最先进的教材。
全书共分20章，章节根据应用于半导体制造的主要技术分类来安排，内容包括：与半导体制作相关的基础技术信息；总体流程图的工艺模型概况，用流程图将硅片制造的主要领域连接起来；具本讲解每一个主要工艺；集成

第一图书网, tushu007.com

<<半导体制造技术>>

书籍目录

第1章 半导体产业介绍第2章 半导体材料特性第3章 器件技术第4章 硅和硅片制备第5章 半导体制造中的化学品第6章 硅片制造中的沾污控制第7章 测量学和缺陷检查第8章 工艺腔内的气体控制第9章 集成电路制造工艺概况第10章 氧化第11章 淀积第12章 金属化第13章 光刻：气相成底膜到软烘第14章 光刻：对准和曝光第15章 光刻：光刻胶显影和先进的光刻技术第16章 刻蚀第17章 离子注入第18章

第一图书网, tushu007.com

<<半导体制造技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com